

SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会

第20回講演会 予稿集

2011 年 12 月 8 日ー9 日

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

主催 公益社団法人応用物理学会 「SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会」

会場案内

講演会会場

愛知産業労働センター ウィンクあいち
(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)

口頭発表

2F～3F 大ホール

ポスター発表・企業展示

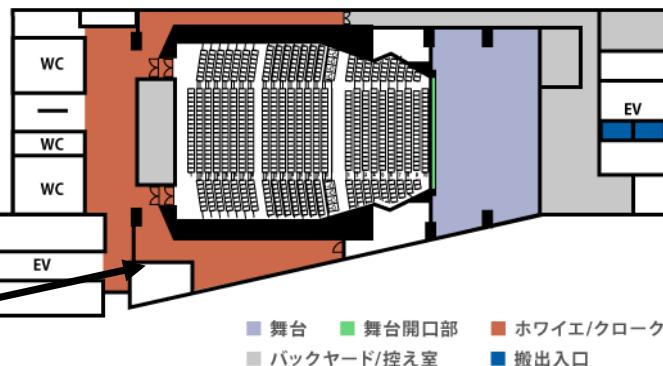
7F 展示場

懇親会

6F 展示場

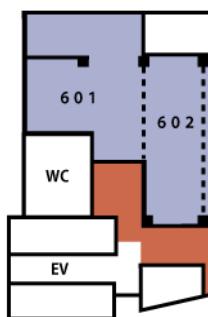
ウィンクあいち 2F～3F

■ 大ホール



口頭発表
Oral Presentation

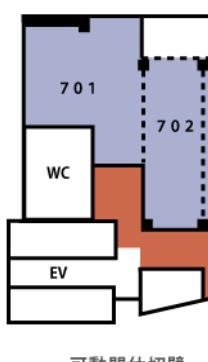
■ 6F



展示場

懇親会
Banquet

■ 7F



展示場

ポスター発表
Poster Session

企業展示
Exhibition

SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第20回講演会

20th Meeting on SiC and Related Wide Bandgap Semiconductors

主催: (公社) 応用物理学会 「SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会」

会場: 愛知県産業労働センター(ワインクあいち) (〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38)

プログラム (Technical Program)

12月8日 (木) (Thursday 8 December)

【大ホール】

10:00-10:10

開会の辞 (Opening Address)

代表幹事 伊藤久義 (日本原子力研究開発機構)

I. 基調講演 10:10~12:25

【大ホール】

10:10-10:55

I-1

電力用機器に適用されるパワーエレクトロニクス技術

Power Electronics Technology applied to Power System Equipment

加藤 徹 (中部電力株式会社 工務技術センター技術グループ)

10:55-11:40

I-2

サステイナブルモビリティーに向けた自動車技術とワイドバンドギャップ半導体への期待

Approach Toward Achieving Sustainable Mobility And Expectations for
Wide-Bandgap Semiconductors

長尾 勝, 松本 巧 (トヨタ自動車(株))

11:40-12:25

I-3

次世代電力システムにおけるパワエレ技術

Power Electronics Technology in Next Generation Power System

鵜飼 裕之, 青木 瞳, 関崎 真也 (名古屋工業大学大学院工学研究科)

((昼食休憩 : 12:25-13:30))

【7階展示場】

13:30-15:30

ポスターセッション (Poster Session) 奇数番号

((コーヒーブレイク Coffee Break : 15:30-15:40))

【7階展示場】

15:40-17:40

ポスターセッション (Poster Session) 偶数番号

((懇親会 Reception : 【6階展示場】 18:00-20:00))

12月9日 (金) (Friday 9 December)

II. 【招待講演】 バルク・エピ成長 9:00-10:15

【大ホール】

9:00-9:25

II-1

昇華再結晶法によるSiC単結晶基板の開発動向

Recent Development of PVT-grown SiC Single Crystal Wafers

藤本 辰雄 (新日本製鐵(株) 先端技術研究所)

		SiCエピタキシャルウエハの生産技術開発 Development of production technology for SiC epitaxial wafers 佐藤 貴幸（昭和電工株式会社 SiC パワーエレクトロニクスプロジェクト）
9:25-9:50	II-2	SiC 溶液成長における貫通転位の変換過程 —Ultra-High Quality の可能性— Conversion process of threading dislocation in SiC solution growth - a step toward the realization of ultra-high quality - 宇治原徹, 原田俊太, 山本祐治, 関和明, 堀尾篤史, 三橋貴仁（名古屋大学大学院工学研究科）

III. 個別討論会報告・【招待講演】欠陥とデバイス特性 9:00-10:15

【7階展示場】 9:00-9:25	III-1	第6回個別討論会報告 畠山 智亮 ¹ , 矢野 裕司 ¹ , 須田 淳 ² (¹ 奈良先端科学技術大学院大学, ² 京都大学大学院工学研究科) SiCの熱酸化膜の信頼性に対する表面欠陥及び転位の影響 Effects of Surface Morphological Defects and Crystallographic Defects on Reliability of Thermal Oxides
9:25-9:50	III-2	畠山哲夫 ^{1, 2, 3} , 鈴木拓馬 ^{2, 3} , 山口博隆 ¹ , 松畑洋文 ¹ , 先崎純寿 ¹ , 福田憲司 ¹ , 四戸孝 ² , 奥村元 ¹ (¹ 産総研 先進パワエレセンター, ² (株)東芝 研究開発センター, ³ (財)新機能素子研究開発協会)
9:50-10:15	III-3	高温・広温度域動作SiCパワーデバイスのための卑金属Zn-Alダイ・アッチメント Common Metal Zn-Al Die Attachment for SiC Power Devices Operated in an Extended Junction Temperature Range 谷本 智 ^{1,2} , 松井 康平 ^{1,3} , 団子 祐輔 ^{1,2} , 佐藤 伸二 ^{1,4} , 村上 善則 ^{1,2} , 高森 雅人 ⁵ , 井関 隆士 ⁵ (¹ FUPET, ² 日産自動車, ³ 富士電機, ⁴ サンケン電気, ⁵ 住友金属鉱山)

((コーヒーブレイク Coffee Break : 10:45-12:00))

IV. 【招待講演】窒化物・酸化物・ダイヤモンド等関連物質 10:45-12:00

【大ホール】 10:45-11:10	IV-1	GaN基板上3mm GaN p-n接合ダイオード Large GaN p-n Junction Diodes of 3 mm in Diameter on Free-Standing GaN Substrates 野本 一貴 ¹ , 中村 徹 ^{1,2} , 金田 直樹 ³ , 河野 敏弘 ³ , 土屋 忠巣 ³ , 三島 友義 ³ (¹ 法政大学 マイクロ・ナノテクノロジー研究センター, ² 法政大学 工学部 電気電子工学科, ³ 日立電線株式会社 技術研究所)
11:10-11:25	IV-2	単結晶酸化ガリウムMESFET Single-Crystal Gallium Oxide MESFET 東脇 正高 ^{1,2} , 佐々木 公平 ³ , 倉又 朗人 ³ , 増井 建和 ⁴ , 山腰 茂伸 ³ (¹ (独)情報通信機構, ² (独)科学技術振興機構さきがけ, ³ (株)タムラ製作所, ⁴ (株)光波)
11:25-11:50	IV-3	SiC上グラフェンチャネルトランジスタの単極性動作と高オン/オフ比実現に向けた試み An attempt for realization of unipolar behavior in graphene channel transistors fabricated on SiC with high on/off ratio 永久 雄一 ¹ , 徳光永輔 ^{1,2} (¹ 東京工業大学 精密工学研究所, ² 北陸先端科学技術大学院大学 グリーンデバイス研究センター)

((昼食休憩 Lunch : 12:00-13:30))

V. 【招待講演】デバイス・プロセス 13:30-15:10

【大ホール】 13:30-13:55	V-1	SiCデバイスプロセスの高度化に向けた新規表面・界面改質技術の開発 Development of Novel Surface and Interface Modification Methods in Advanced SiC Device Processes
		冬木 隆, 矢野 裕司, 畠山 智亮 (奈良先端大学院)
13:55-14:20	V-2	SiC熱酸化機構の解明への取り組み An Attempt for the Clarification of SiC Thermal Oxidation Mechanism
		土方 泰斗 ¹ , 矢口 裕之 ¹ , 吉田 貞史 ² (¹ 埼玉大学 大学院理工学研究科, ² 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)
14:20-14:45	V-3	パワー半導体パッケージ・実装技術 Package Design and Assembly technologies for Power semiconductor devices
		池田 良成, 望月 英司, 高橋 良和 (富士電機株式会社)
14:45-15:10	V-4	高電流増幅率SiCバイポーラトランジスタの実現 Development of High-Current-Gain SiC Bipolar Junction Transistors
		三宅 裕樹 ¹ , 木本 恒暢 ^{1,2} , 須田 淳 ¹ (¹ 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻, ² 京都大学光・電子理工学センター)

((コーヒーブレイク Coffee Break : 15:10-15:40))

VI. 【招待講演】システム・機器応用 15:40-17:20

【大ホール】 15:40-16:05	VI-1	瞬時値シミュレーションを用いたインバータの最適設計 Optimal Design for Inverters using Transient Simulation
		菊間 俊明, 岡田有功, 高崎昌洋 (電力中央研究所)
16:05-16:30	VI-2	5 nH低インダクタンスSiCパワーモジュールと40kW/Lインバータの開発 5 nH low-inductance SiC power module for 40 kW/L inverter
		松井 康平 ^{1,2} , 佐藤 伸二 ^{1,3} , 団子 祐輔 ^{1,4} , 谷本 智 ^{1,4} , 村上 善則 ^{1,4} , (¹ 技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET), ² 富士電機(株), ³ サンケン電気(株), ⁴ 日産自動車(株))
16:30-16:55	VI-3	SiCデバイス開発と機器への適用 Development of SiC power devices and their applications
		今泉 昌之 ¹ , 大森 達夫 ² (¹ 三菱電機 先端技術総合研究所, ² 三菱電機 パワーデバイス製作所)
16:55-17:20	VI-4	社会インフラ機器向けSiC パワーデバイス開発 Development of SiC power devices for power conversion systems used in various social infrastructures
		四戸 孝 ((株)東芝研究開発センター 電子デバイスラボラトリー)
【大ホール】 17:20-		研究奨励賞授賞式
		閉会の辞 (Closing Remarks)
		代表幹事 伊藤久義 (日本原子力研究開発機構)

ポスター講演プログラム

(講演者の前に記載の▲は、奨励賞申請講演であることを示す。)

- P-1 SiC溶液成長法の3次元数値解析モデル
3-Dimensional Numerical Analysis Model of SiC Solution Growth
▲岡田信宏¹、亀井一人¹、楠一彦¹、矢代将斎¹、森口晃治¹、大黒寛典²、加渡幹尚²、鈴木寛²、坂元秀光²、別所毅² (¹住友金属工業株式会社 総合技術研究所、²トヨタ自動車株式会社 東富士研究所)
- P-2 SiC 溶液成長における溶媒の熱力学物性と坩堝内反応：CALPHAD 法を利用した解析
Thermodynamic properties of solvents and Chemical reactions in crucible for SiC solution growth:
Computational analyses using CALPHAD method
森口晃治¹、岡田信宏¹、亀井一人¹、楠一彦¹、矢代将斎¹、大黒寛典²、加渡幹尚²、鈴木寛²、坂元秀光²、別所毅² (¹住友金属工業(株)総合技術研究所、²トヨタ自動車株式会社)
- P-3 Si/Cr系溶媒を用いた引上げ法による4H-SiC バルク結晶成長
Top-Seeded Solution Growth of 4H-SiC Bulk Crystal
Using Si-Cr Based Melt
▲大黒寛典¹、加渡幹尚¹、鈴木寛¹、坂元秀光¹、別所毅¹、楠一彦²、矢代将斎²、森口晃治²、岡田信宏²、亀井一人² (¹トヨタ自動車株式会社 東富士研究所、²住友金属工業株式会社 総合技術研究所)
- P-4 Si-Ti-C溶液から成長させた4H-SiC単結晶の結晶性評価
Crystallinity evaluation of 4H-SiC single crystal grown by solution growth technique using Si-Ti-C solution
亀井一人¹、楠一彦¹、矢代将斎¹、岡田信宏¹、森口晃治¹、大黒寛典²、加渡幹尚²、鈴木寛²、坂元秀光²、別所毅² (¹住友金属工業(株)総合技術研究所、²トヨタ自動車株式会社 先端材料技術部)
- P-5 炭化珪素薄膜の室温形成法
Room Temperature Process for Producing Silicon Carbide Thin Film
津地雅希、安藤祐介、羽深等 (横国大院工)
- P-6 RAF結晶中の基底面転位構造のフーリエ変換解析
Fourier Transform Analysis of Basal Plane Dislocation Structure in Repeated a-face Grown Crystals
郡司島造^{1,2}、浦上泰^{1,3}、廣瀬富佐雄^{1,3}、安達歩^{1,4}、恩田正一^{1,3}、西川恒一^{1,2} (¹新材料パワー半導体研究開発センター日進分室、²株式会社豊田中央研究所、³株式会社デンソー、⁴トヨタ自動車株式会社)
- P-7 二次元核生成理論を用いたSiC結晶多形の決定要因の解明
Clarification of determining factor of SiC polytype using 2D nucleation theory
▲白桃拓哉¹、高冰²、中野智²、西澤伸一³、寒川義裕^{1,2}、柿本浩一^{1,2} (¹九州大学大学院工学府、²九州大学応用力学研究所、³産業技術総合研究所)
- P-8 3C-SiC(001)面上の積層欠陥を確実に解消する技術
Reliable Technology for Reducing Stacking Faults on 3C-SiC(001)
八田直記、池邊洋平、河原孝光、八木邦明、長澤弘幸 (HOYA株式会社)
- P-9 自然対流抑制下Fe-Si溶媒を用いた温度差法によるSiC溶液成長挙動の調査
Investigation of the Solution Growth Behavior of SiC by the Temperature Difference Method utilizing Fe-Si Solvent under the Suppression of Natural Convection
▲川西咲子¹、吉川健²、森田一樹² (¹東京大学大学院工学系研究科、²東京大学生産技術研究所)
- P-10 4H-SiC 微傾斜Si面基板上に作製したエピタキシャル膜の表面モフォロジーと多形制御

Surface morphology and polytype control of epitaxial layer grown on 4H-SiC vicinal off angled Si-face substrate

児島一聰^{1,2}、長田晃代²、奥村元^{1,2} (¹技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²(独)産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)

RAF法(Repeated α -face)による螺旋転位の低減

TSD Reduction by RAF (repeated α -face) Growth Method

P-11 浦上泰^{1,2}、郡司島造^{1,3}、山口聰^{1,3}、近藤宏行^{1,2}、廣瀬富佐雄^{1,2}、(¹技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²株式会社デンソー 基礎研究所、³株式会社豊田中央研究所、⁴トヨタ自動車株式会社)

SiCエピタキシャルウェハの帯状欠陥へのバルク基板表面ダメージによる影響

Influence on belt-shaped defects of SiC epitaxial wafer from bulk substrate surface damages

P-12 田村謙太郎^{1,3}、大島博典¹、杉山直之¹、松畑洋文^{1,2}、北畠真^{1,4}、児島一聰^{1,2}、大野俊之^{1,5} (¹技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²独立行政法人産業技術総合研究所、³ローム株式会社、⁴パナソニック株式会社、⁵株式会社日立製作所)

4H-SiC溶液成長におけるポイド抑制法

Control of void formation in 4H-SiC solution growth

P-13 三谷武志^{1,2}、岡村雅之²、高橋徹夫^{1,2}、小松直佳¹、加藤智久^{1,2}、奥村元^{1,2} (¹次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²産業技術総合研究所)

横型ホットCVD法によるHMDS+HCDS+C₃H₈+H₂を用いた4H-SiCのエピタキシャル成長

Epitaxial growth of 4H-SiC using HMDS + HCDS + C₃H₈ + H₂ System by horizontal hot-wall CVD system

P-14 H. S. Lee¹、M. J. Kim¹、S. I. Lee¹、W. J. Leed¹、B. C. Shine¹、and S. Nishinof² (¹Department of Materials & Components Engineering、Electro Ceramic Center、Dong-eui University、995 Eomgwangno、Busanjin-gu、Republic of Korea、²Widgap Materials Inc. Kyoto Institute of Technology、Sakyo-ku、Kyoto、606-8585、Japan)

成長速度論的多形選択成長を用いた3C-SiCバルク結晶の実現

P-15 Realization of 3C-SiC bulk crystal using kinetic polytype-selective growth

▲関和明、山本祐治、原田俊太、宇治原徹、竹田美和(名古屋大学工学研究科)

溶液法を用いた4H-SiC結晶における貫通らせん転位の消滅

P-16 Disappearance of threading screw dislocations in 4H-SiC crystal by solution method

山本祐治、原田俊太、関和明、堀尾篤史、三橋貴仁、宇治原徹(名古屋大学大学院工学研究科)

貫通転位上の表面形態が4H-SiCダイオードのリーク電流に与える影響

Impact of Surface Morphology above Threading Dislocations on Leakage Current in 4H-SiC Diodes

P-17 藤原広和、勝野高志、石川剛、成岡英樹、小西正樹、遠藤剛、渡辺行彦、山本敏雅、鶴田和弘、恩田正一、長尾勝、濱田公守(トヨタ自動車株式会社)

基板表面の浅い転位を起源とするエピ膜中欠陥の発生と研磨最適化による抑制

Defect generation in epitaxial film by propagation from shallow dislocations on the wafer

P-18 and the suppression of defect generation by proper mechanical polish

石川由加里¹、佐藤功二¹、岡本好弘²、林紀孝²、姚永昭¹、菅原義弘¹ (¹財団法人ファインセラミックスセンター、²株式会社アクト)

4H-SiC の貫通螺旋転位線の傾きがエッチピットサイズに及ぼす影響

P-19 Effect on the etch pit size of the tilt of threading screw dislocation in 4H-SiC crystal fabricated by sublimation method

石川由加里¹、姚永昭¹、菅原義弘¹、旦野克典²、鈴木寛²、別所毅² (¹財)ファインセラミックスセンター、²トヨタ自動車株式会社)

4H-SiCエピタキシャル層に発生した積層欠陥のHR-TEM観察

P-20 HR-TEM Observation of Stacking Faults in 4H-SiC Epitaxial Layers

川野輪仁¹、西田幸子¹、青木正彦¹、馮淦²、木本恒暢² (¹(株)イオンテクノセンター、²京都大学大学院工学研究科)

放電電流過渡分光法を用いた犠牲酸化処理された高純度半絶縁性4H-SiCの放出割合の温度依存性

Temperature Dependence of Emission Rate in Sacrifice-Oxidized High-Purity Semi-Insulating 4H-SiC by

P-21 Discharge Current Transient Spectroscopy

▲西川 誠二¹、岡田 亮太¹、松浦 秀治¹ (¹大阪電気通信大学)

階段状貫通転位と浅いハーフループ転位の検出

Detection of stepwise threading dislocation and shallow half-loop dislocation

P-22 石川由加里¹、菅原義弘¹、姚永昭¹、佐藤功二¹、旦野克典²、鈴木寛²、別所毅² (¹財団法人ファインセラミックスセ

ンター、²トヨタ自動車株式会社)

硬X線電子分光法によるNiシリサイド/4H-SiC構造中のカーボン結合状態評価

Chemical bonding states of carbon atoms in Ni silicide/4H-SiC systems

P-23 analyzed by hard X-ray photoelectron spectroscopy

▲土屋 義規、四戸 孝 ((株)東芝研究開発センター、電子デバイスラボラトリー)

4H-SiCエピ膜中のZ_{1/2}センターに対する点欠陥低減プロセス条件の評価

P-24 Evaluation of Process Conditions for Reduction of Z_{1/2} Center in 4H-SiC Epilayers

宮澤哲哉、土田秀一 ((財)電力中央研究所 材料科学研究所)

MSE成長によってTSDからFrank欠陥へと変換した転位のバーガースペクトル解析

Analysis of Burgers vectors of the dislocation converted from TSD to Frank Fault by MSE growth

P-25 ▲浜田信吉¹、吉岡久¹、川見浩¹、中村信彦¹、瀬戸口佳孝¹、松浪徹¹、西川公人¹、一色俊之² (¹株式会社エコトロ

ン、²京都工芸繊維大学)

キャリアライフタイムのエピ厚依存性観測による4H-SiC表面再結合速度評価

Estimation of the surface recombination velocity for 4H-SiC by observing thickness dependence of the carrier lifetime

加藤正史、吉田敦史、市村正也 (名古屋工業大学)

低エネルギー電子線照射を施したp型4H-SiCに存在する深い準位の観測

Observation of deep levels in p-type 4H-SiC induced by low-energy electron irradiation

P-27 ▲吉原一輝¹、加藤正史¹、市村正也¹、畠山智亮²、大島武³ (¹名古屋工業大学、²奈良先端科学技術大学院大学、³日本原子力開発研究機構)

炭化ケイ素ウェハにおける成長転位の評価

P-28 As-grown dislocations in SiC wafers

奥野憲一郎¹、丸山隆之¹、吉川雅人¹ (¹株式会社ブリヂストン)

電子線照射下における4H-SiC基底面転位の分解

Dissociation of basal plane dislocations in 4H-SiC under electron beam irradiation observed by electron

P-29 beam induced current and KOH+Na₂O₂ etching

▲姚永昭¹、菅原義弘¹、石川由加里¹、旦野克典²、鈴木寛²、別所毅² (¹ファインセラミックスセンター、²トヨタ自動車株式会社)

X線トポグラフによる4H-SiCバルク単結晶の結晶欠陥評価

P-30 Characterization of crystallite defects in 4H-SiC bulk single crystal by X-ray topograph

近藤 宏行、鷹羽 秀隆、浦上 泰、廣瀬 富佐雄、山内 庄一、恩田 正一 ((株)デンソー)

顕微フォトルミネッセンスを用いた4H-SiCエピ膜中積層欠陥に対する酸化の影響に関する研究

P-31 Micro-Photoluminescence study on the influence of oxidation on stacking faults in 4H-SiC epilayers

▲山形光、土方泰斗、矢口裕之 (埼玉大院理工研)

放射光を用いた斜入射X線トポグラフ法による4H-SiC結晶中のフランク型およびショックレー型積層欠陥の解析
Analysis of Frank type and Shockley type stacking faults in 4HSiC by grazing incident synchrotron X-ray topography

P-32 松畠洋文、山口博隆 (産業技術総合研究所、先進パワーエレクトロニクス研究センター、つくば市梅園1-1-1)

我々は斜入射X線トポグラフ法により、各種欠陥構造と、電力素子の歩留まり等の関係を調べいくつかの知見を得て来た。その過程で本手法で観察される欠陥の識別のための表を作成してきた。フランク型およびショックレー型の積層欠陥が一枚入った状態について観察結果を整理し、欠陥識別のための知見を得たので報告する。

SiC中の深い準位制御に向けた熱酸化後の深い準位分布予測

Prediction of deep-level distributions in SiC after thermal oxidation

P-33 川原洸太朗¹、須田淳¹、木本恒暢^{1,2} (¹京都大学工学研究科、²京都大学工学研究科 光・電子理工学教育研究センター)

断面・平面TEM観察を用いた4H-SiCエピ膜のフランク型基底面転位の構造評価

Microstructural Characterization of Frank-type Basal Plane Dislocations in 4H-SiC Epitaxial layers

P-34 by Cross-Sectional and Plane View TEM

迫秀樹¹、橋本秀樹¹、吉川正信¹、佐々木将²、木本恒暢² (¹東レリサーチセンター、²京都大学工学研究科電子工学専攻)

透過型電子顕微鏡による4H-SiCエピウェーハの三角欠陥起点の解析

Characterization of Triangular-Defects on 4H-SiC Epitaxial Wafers by Transmission-Electron Microscopy

P-35 山下任^{1,2}、宮坂佳彦^{1,2}、山竹邦明^{1,2}、武藤大祐^{1,2}、百瀬賢治^{1,2}、佐藤貴幸^{1,2}、松畠洋文^{1,3}、北畠真¹ (¹技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²昭和电工株式会社、³独立行政法人 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)

斜入射放射光X線トポグラフィーおよびフォトルミネッセンスイメージングによる4H-SiCエピウェーハ上三角欠陥の構造解析

Characterization of Triangular-Defects on 4H-SiC Epitaxial Wafers by Grazing Incidence Synchrotron Reflection X-ray Topography and by Photo-Luminescence Imaging

山下任^{1,2}、百瀬賢治^{1,2}、武藤大祐^{1,2}、下平祥貴^{1,2}、小田原道哉^{1,2}、影島慶明^{1,2}、宮坂佳彦^{1,2}、山竹邦明^{1,2}、佐藤貴幸^{1,2}、松畠洋文^{1,3}、北畠真¹ (¹技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²昭和电工株式会社、³独立行政法人 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)

3C-SiCウェハーにおける過剰キャリアライフタイムと歪みの断面観察

P-37 Cross sectional observation of strains and excess carrier lifetimes in a 3C-SiC wafer

▲吉田敦史、加藤正史、市村正也 (名古屋工業大学)

大角度収束電子線回折法による六方晶系SiCの転位構造解析

Characterization of Dislocation Structures in Hexagonal SiC by LACBED method

P-38 菅原義弘¹、姚永昭¹、石川由加里¹、旦野克典²、鈴木寛²、別所毅²、幾原雄一^{1,3} (¹財団法人ファインセラミックスセンター、²トヨタ自動車株式会社、³東京大学)

P-39 ドーピング密度の異なる4H-SiC エピ膜内の基底面転位の解析

Basal plane dislocations in 4H-SiC epilayers with different dopings

▲Xuan Zhang¹、Masahiro Nagano¹、Hidekazu Tsuchida¹ (Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI))

This paper reports our studies on the morphologies of BPDs in 4H-SiC epilayers doped with N or Al. Detailed structures of BPDs were studied by TEM.

n型4H-SiCのFano干渉効果の高濃度領域におけるキャリア濃度依存性

P-40 Free carrier dependence of Fano profiles in Raman spectra of 4H-SiC

三谷武志、中島信一、加藤智久、児島一聰、奥村元 (産業技術総合研究所)

フォトルミネッセンス法を用いた4H-SiC中積層欠陥拡張における駆動力の研究

Photoluminescence study of the driving force for stacking faults expansion in 4H-SiC

P-41 ▲平野梨伊^{1,2}、佐藤勇樹³、田島道夫¹、伊藤公平²、前田康二³ (¹宇宙航空研究開発機構、²慶應義塾大学理工学研究科基礎理工学専攻、³東京大学工学系研究科物理工学専攻)

X線3Dトポグラフィーによる4H-SiC基底面転位および貫通刃状転位のイメージング

P-42 X-ray three-dimensional topography imaging of basal-plane and threading-edge dislocations in 4H-SiC

田沼良平¹、森大輔²、鎌田功穂¹、土田秀一¹ (¹電力中央研究所、²富士電機)

エピ膜結晶表面の積層欠陥と微小欠陥の光学観察と構造評価

Optical Observation and Structure Evaluation for Stacking Faults and Pit Dislocations in 4H-SiC Epilayer

P-43 田中 俊明¹、杉山 直之¹、大島 博典¹、松畑 洋文^{1,2}、北畠 真¹ (¹技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²産業技術研究所先進パワーエレクトロニクスセンター)

4H-SiCエピ膜結晶の励起準位と積層欠陥エネルギー準位の相関解析

Correlation between Excited Level and Energy Level of Stacking Faults in 4H-SiC Epilayer

P-44 田中 俊明¹、松畑 洋文^{1,2}、北畠 真¹ (¹技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²産業技術研究所先進パワーエレクトロニクスセンター)

塩素ガス熱エッティング法による4H-SiC Si面上のサブトレンチ解消と微細加工

Elimination of sub-trenches and microfabrication in 4H-SiC Si-face by thermal etching in chlorine gas

P-45 繁瀬 英典¹、畠山 智亮¹、戸所 義博²、矢野 裕司¹、冬木 隆¹ (¹奈良先端大 物質創成科学研究科、²奈良先端大 産官学連携推進本部)

4H-SiCにおける遷移金属元素の拡散とゲッタリング

Diffusion and gettering of transition metals in 4H-SiC

P-46 旦野克典、斎藤広明、関章憲、白井嵩幸、鈴木寛、別所毅、河合洋一郎、木本恒暢 (トヨタ自動車株式会社、京都大学)

三フッ化塩素ガスにより4H-SiC表面に形成されるエッチピット(2)

P-47 4H-SiC Surface Pits Formed due to Etching Using ClF₃ Gas (2)

福元裕介¹、古川和親¹、羽深等¹、加藤智久² (¹横国大院工、²産総研)

コールドウォール型SiCゲート酸化膜形成装置を用いた酸化膜の高温形成および高温窒化

High temperature gate oxidation and nitridation using cold-wall type RTP SiC gate oxidation system

P-48 小杉亮治¹、鍵山真也²、手塚和男²、清水三郎²、横山政史³、津田勝美³ (¹(独)産業技術総合研究所、²(株)アルパック半導体電子技術研究所、³アルパック理工(株))

プラズマ発生領域制限マスクを用いたPCVMによるSiC基板のダイシングの検討

P-49 Dicing of SiC with slit mask for plasma confinement

▲西川央明、佐野泰久、会田浩平、Chaiyapat Tangpatjaroen、山村和也、松山智至、山内和人 (大阪大学大学院工学研究科精密科学・応用物理専攻)

レーザーアニールによるSiCデバイスのオーミック電極の形成

P-50 Formation of ohmic electrode by Laser anneal

河合 潤、加藤 信之、加藤 良隆 (株式会社デンソー 機能材料研究部)

SiC表面炭化反応をプローブに用いた耐高温材料TaC部材効果の検証

A study of the effect of refractory materials TaC as a high temperature vapor phase applications in annealing process from SiC carbonization mechanism

鳥見 聰¹、野上 晓¹、牛尾 昌史²、金子 忠昭^{2,3} (¹東洋炭素株式会社 東洋炭素生産技術センター、²関西学院大学 理工学部、³関西学院大学 SiC材料・プロセス研究開発センター)

ペプチド自己組織化膜を用いたSiC(000-1)表面のナノ微細加工

Nanostructure formation of SiC(000-1) surface by using Self-Assembled monolayers.

P-52

川口優作¹、永利一幸²、江龍修¹ (¹名古屋工業大学大学院産業戦略工学専攻、²株式会社フジミインコーポレーテッド)

高ドーズイオン注入した4H-SiC中の格子不整合および結晶軸の傾斜

P-53 Lattice Mismatch and Crystallographic Tilt Induced by High-dose Ion-implantation into 4H-SiC

▲佐々木将、須田淳、木本恒暢 (京都大学大学院工学研究科電子工学専攻)

SiC表面原子ステップが及ぼす電気特性評価

Electronic Characterization on SiC surface of atomic step

P-54

田中 弥生¹、神田 隆生²、永利 一幸³、吉村 雅満⁴、江龍 修¹ (¹名古屋工業大学大学院、²ポバール興業株式会社、³株式会社フジミインコーポレーテッド、⁴豊田工業大学)

SiCの水分解応用におけるポリタイプおよび結晶品質依存性の評価

P-55 Polytype and crystalline quality dependence of SiC for a water splitting application

▲安田智成¹、加藤正史¹、市村正也¹、畠山智亮² (¹名古屋工業大学大学院、²奈良先端科学技術大学院大学)

触媒表面基準エッティング法を用いた4H-SiCの平坦化加工における反応種の検討

Study on reactive species in catalyst-referred etching of 4H-SiC

P-56

橘一真¹、佐野泰久¹、岡本武志¹、磯橋藍¹、有馬健太¹、八木圭太²、定國峻¹、山内和人¹ (¹大阪大学 大学院工学研究科、²株式会社 莢原製作所)

触媒表面基準エッティング法による4H-SiC基板の平坦化加工における加工速度の向上

Improvement of Removal Rate of 4H-SiC Substrate in Catalyst-referred Etching

P-57

▲磯橋藍¹、佐野泰久²、岡本武志²、橘一真²、有馬健太²、八木圭太³、定國峻²、山内和人² (¹大阪大学工学部応用自然科学科、²大阪大学大学院工学研究科、³荏原製作所)

インゴット回転台を用いた炭化ケイ素のワイヤー放電加工

EDM of SiC Ingot on Turn Table

P-58

山本則正¹、赤星勇利¹、山田秀貴¹、加藤智久^{2,3}、山口作太郎¹ (¹中部大学、²技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究機構、³産業技術総合研究所)

熱エッティング速度のSiC結晶面方位依存性

P-59 Thermal etching rate dependence of orientation of SiC substrates

田村哲也、畠山智亮、纒纒英典、矢野裕司、冬木隆 (奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科)

P-60 高速マルチワイヤーソーによるSiCインゴットの高速切断

High-speed slicing of SiC ingot by High-speed Multi Wire Saw

前田弘人^{1,3}、出口喜宏^{1,3}、高鍋隆一^{1,4}、松田祥伍^{1,3}、加藤智久^{1,2} (¹次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPE)²産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター、³株式会社タカトリ、⁴旭ダイヤモンド工業株式会社)

Si蒸気圧エッティングを用いた4H-/6H-SiC [0001] 表面のステップ-テラス熱安定性

Temperature dependence of 4H-/6H-SiC [0001] step-terrace structures during Si-vapor etching

P-61

▲萩原健太¹、唐木竜也¹、牛尾昌史¹、大谷昇^{1,2}、金子忠昭^{1,2} (¹関西学院大学 理工学研究科、²関西学院大学 SiC材料・プロセス研究開発センター)

ステップポリッシュ法によるSiCウェーハ加工歪層深さの評価

Evaluation of surface damaged layer depth on SiC substrates by the Step-Polish method

P-62

堀田和利^{1,2}、河田研治^{1,2}、長屋正武^{1,3}、貴堂高徳^{1,4}、加藤智久^{1,5} (¹技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²株式会社フジミインコーポレーテッド、³株式会社デンソー、⁴昭和電工株式会社、⁵独立行政法人 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)

化学量論比自律制御Si蒸気圧エッティングによる転位起因の4H-SiC(0001)表面構造

Surface structure originated from dislocation on 4H-SiC(0001)basal plane during Si-vapor etching

P-63

▲中西耕平¹、牛尾昌史¹、大谷昇^{1,2}、金子忠昭^{1,2} (¹関西学院大学 理工学研究科、²関西学院大学 SiC材料・プロセス研究開発センター)

SiC単結晶切断用マルチワイヤー放電加工機の開発

Development off Multi-wire Electric Discharge Machining for SiC slicing

P-64

堀江裕一郎^{1,2}、淵山正毅^{1,2}、多和靖展^{1,2}、吉川直樹^{1,2}、加藤智久^{1,3} (¹技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPE)²東京カソード研究所、³独立行政法人 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)

SiC放電加工の放電率と加工速度との関係

Relationship between discharge ratio and cutting speed of electric discharge machining for SiC

P-65

▲山田秀貴¹、山本則正¹、山口作太郎¹、加藤智久^{2,3} (¹.中部大学、².技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究機構、³.産業総合研究所)

熱酸化における4H-SiC中の欠陥の理論的検討

Theoretical studies on effects of defects in 4H-silicon carbide for thermal oxidation

P-66

吉崎智浩¹、海老原康裕¹、長川健太¹、加藤重徳¹、神谷克政¹、白石賢二¹ (¹筑波大学大学院数理物質科学研究科物質創成先端科学専攻、²筑波大学理工学群物理学類)

高温条件下における4H-SiC MOSデバイスの不安定性

Bias temperature instability in 4H-SiC metal-oxide-semiconductor devices

P-67

▲Atthawut Chanthaphan¹、桐野嵩史¹、上西悠介¹、池口大輔¹、箕谷周平²、中野佑紀²、中村孝²、細井卓治¹、志村考功¹、渡部平司¹ (¹大阪大学大学院工学研究科、²ローム株式会社)

ウェット再酸化及びN₂OアニールによるpチャネルSiC MOSデバイスの界面特性の改善

Improvement of MOS interface properties for p-channel SiC MOS devices by wet reoxidation or N₂O

P-68

annealing process

片上 崇治^{1,2}、新井 学^{1,2}、竹中 研介^{1,3}、米澤 喜幸^{1,3}、石森 均¹、岡本 光央¹、児島 一聰¹、福田 嘉司¹ (¹産業技術総合研究所、²新日本無線株式会社、³富士電機株式会社)

斜視角入射 X 線反射法による SiO₂/4H-SiC (0001) 界面遷移層の解析

P-69

Analysis of an Interfacial Layer in SiO₂/4H-SiC (0001) Using Grazing Incidence X-ray Reflectivity

▲加藤棟治¹、須田淳¹、木本恒暢¹ (¹京都大学大学院工学研究科電子工学専攻)

4H-SiC表面に対する窒素熱処理による酸化膜界面の改善

- P-70 Enhancing Interface Quality by applying Nitrogen-Conditioning to 4H-SiC Surface
長野正裕、ジョン・ローゼン、土田秀一 (電力中央研究所)

Wet酸化時に形成される負の固定電荷に関する理論的検討

- P-71 Intrinsic Origin of Negative Fixed Charge in Wet Oxidation for Silicon Carbide
▲海老原康裕、長川健太、加藤茂徳、吉崎智浩、神谷克政、白石賢二 (筑波大学大学院)

4H-SiC表面の初期酸化過程の第一原理計算による考察

- P-72 First Principles Analysis of Initial Oxidation Process of 4H-SiC Surfaces
長川健太、加藤重徳、海老原康裕、吉崎智浩、神谷克政、白石賢二 (筑波大学物理)

4H-SiC表面のNO初期酸化過程の第一原理計算による検討

- P-73 First-Principles Analysis of NO Initial Oxidation Process of 4H-SiC Surfaces
加藤重徳、海老原康裕、吉崎智浩、長川健太、神谷克政、白石賢二 (筑波大学大学院数理物質科学研究科)

4°/ 8°オフ4H-SiC上MOSキャパシタのTDDBに与えるTSDの影響

- P-74 Influence of TSD exerted on MOS capacitors TDDB on 4 / 8 degrees off 4H-SiC
鈴木秀和、鈴木賢二、坂東章、佐藤貴幸 (昭和电工株式会社 研究開発本部 SiCパワーエレクトロニクスプロジェクト)

紫外線照射による熱酸化SiO₂/SiC構造中の電気的欠陥生成

- P-75 Investigation of UV-induced electrical defects in thermally grown SiO₂/SiC structures
▲池口大輔¹、桐野嵩史¹、箕谷周平²、中野佑紀²、中村孝²、細井卓治¹、志村考功¹、渡部平司¹ (¹大阪大学大学院工学研究科、²ローム株式会社)

高純度オゾンを用いたSiCゲート酸化膜形成

SiC gate-dielectric film formation using high-purity ozone gas.

- P-76 亀田直人¹、小杉亮治²、奥村元²、中村健³、野中秀彦³、三浦敏徳¹ (¹(株)明電舎、静岡県沼津市東間門字上中溝515 e-mail:n-kameda@aist.go.jp、²(独)産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター、茨城県つくば市梅園1-1-1、³(独)産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門、茨城県つくば市梅園1-1-1)

第一原理分子動力学法で生成したアモルファスSiO₂/4H-SiC(11-20)原子構造モデル

An amorphous SiO₂/4H-SiC(11-20) interface atomic model generated by first-principals molecular dynamics method

- P-77 宮下敦巳¹、大沼俊治²、土田秀一²、吉川正人¹ (¹日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門、²電力中央研究所 材料科学研究所)

P-OCl₃アニールした4H-SiC MOS構造の高電界ストレスによる電気特性への影響

- P-78 Effects of high field stress on electrical properties of POCl₃-annealed 4H-SiC MOS capacitors
森下隆至、矢野裕司、畠山智亮、冬木隆 (奈良先端科学技術大学院大学)

n型4H-SiCエピタキシャル層上に500°C熱処理により形成したTiショットキー電極の順方向I-V特性におけるショットキーボルト高さの不均一性の解析

- P-79 Analysis of inhomogeneous schottky barrier height obtained from forward I-V characteristics in Ti/n-type 4H-SiC epitaxial layer formed by 500°C annealing
小野修一、中田大輔、新井学、山崎王義 (新日本無線株式会社)

- MOS構造の電気的特性に対する4H-SiCエピ層中積層欠陥の影響
 P-80 Influence of stacking faults in 4H-SiC epilayers on the electrical characteristics of MOS structures
 外谷彰悟、土方泰斗、矢口裕之 (埼玉大学)
- 4H-SiC MOS界面特性におけるNOとPOCl₃アニールの組み合わせ効果
 P-81 Combination of NO and POCl₃ annealing for 4H-SiC MOS interface
 ▲荒岡 幹、矢野裕司、畠山智亮、冬木 隆 (奈良先端科学技術大学院大学)
- 熱酸化に伴うSiO₂/4H-SiC(0001)表面および界面ラフネス増加
 P-82 Roughness Growth at SiO₂/4H-SiC(0001) Surface and Interface during Thermal Oxidation
 深澤辰哉¹、小杉亮治²、石田夕起²、蓮沼 隆¹、山部紀久夫¹ (¹筑波大学 電子・物理工学専攻、²産業総合技術研究所)
- ダメージ導入プロセスとその後の表面処理がSiC/SiO₂構造に与える影響
 P-83 Impacts of Surface Treatment after Damage-Inducing Process on SiC/SiO₂ Structure
 ▲南園悠一郎¹、須田淳¹、木本恒暢¹ (南園悠一郎1、須田淳1、木本恒暢1)
- SiCショットキーバリアダイオードのリーク電流バラツキを抑制する許容ナノピット密度
 Critical density of nanoscale pits for suppressing variability in leakage current of SiC-SBDs
 P-84 石川 剛¹、勝野 高志¹、渡辺 行彦¹、藤原 広和²、森野 友生³ (¹(株)豊田中央研究所、²トヨタ自動車(株)、³(株)デンソー)
- SiO₂/p型4H-SiC界面特性におけるPOCl₃アニールの効果
 Effects of POCl₃ Annealing on SiO₂/p-type 4H-SiC Interface properties
 ▲高上 稔充、矢野 裕司、畠山 智亮、冬木 隆 (奈良先端科学技術大学院大学)
- P-85 これまでPOCl₃アニールによりリンを界面に導入し、SiO₂/n型4H-SiC界面における伝導帯側の界面準位密度の低減に成功している。今回はp型4H-SiCのMOSキャパシタを作製し、POCl₃アニールが価電子帯側の界面準位に与える効果を調査した。その結果、リンによる界面特性の改善は見られなかった。
- 4H-SiCショットキー・バリア・ダイオードのリーク電流源の解析
 Analysis of leakage current sources of 4H-SiC Schottky barrier diodes
 P-86 勝野高志¹、渡辺行彦¹、石川剛¹、藤原広和²、小西正樹²、森野友生³、遠藤剛³ (¹(株)豊田中央研究所、²トヨタ自動車(株)、³(株)デンソー)
- 擬似多階調リサーフ構造を適用した13 kV級SiCダイオードの耐圧特性
 Breakdown Characteristics of 13 kV-class SiC Diodes with Pseudo-multi-level RESURF Structure
 P-87 ▲濱田 憲治¹、川上 剛史¹、今泉 昌之¹、炭谷 博昭¹、大森 達夫²、木本 恒暢³ (¹三菱電機(株) 先端技術総合研究所、²三菱電機(株) パワーデバイス製作所、³京都大学大学院工学研究科)
- 炭素注入または熱酸化を施した4H-SiC pinダイオードの順方向特性
 P-88 Forward Characteristics of 4H-SiC pin Diode with Carbon Implantation or Thermal Oxidation
 田中篤嗣¹、中山浩二¹、浅野勝則¹、宮澤哲哉²、土田秀一² (¹関西電力株式会社、²電力中央研究所)
- フェニルボロン酸を用いた糖センサの作製
 P-89 Formation of SiC sensor with PBA for glucose and fructose
 田中 弥生¹、神田 隆生²、江龍 修¹ (¹名古屋工業大学大学院、²ポバール興業株式会社)
- 1200V SiC Trench MOSFETの開発
 Development of 1200V SiC trench MOSFET
 P-90 山本敏雅¹、鈴木巨裕¹、松木英夫¹、山本建策¹、鶴田和弘¹、奥野英一¹、恩田正一¹、副島成雅²、石川剛²、渡辺行

彦²、杉本雅裕³ (¹(株)デンソー 機能材料研究部、²(株)豊田中央研究所、³トヨタ自動車(株))

陽極酸化欠陥抑制法によるn型4H-SiCショットキーダイオード順方向特性の改善

P-91 Improvement of forward characteristics for n-type 4H-SiC Schottky diode using passivation of defects by anodic oxidation.

▲木村允哉、加藤正史、市村正也 (名古屋工業大学)

横型および縦型3C-SiC MOSFETの高温動作特性

P-92 High Temperature Performance of Lateral and Vertical 3C-SiC MOSFETs

内田 英次、南 章行、坂田 豊和、長澤 弘幸、小林 元樹 (HOYA株式会社)

トレンチダメージ除去プロセスによる側面ラフネス改善

Effect of etching treatment on side wall roughness of SiC Trench MOSFET

P-93 ▲宮原真一朗¹、渡辺弘紀¹、山本敏雅¹、鶴田和弘¹、恩田正一¹、副島成雅²、渡辺行彦²、森本淳³ (¹(株)デンソー 機能材料研究部、²(株)豊田中央研究所、³トヨタ自動車(株))

埋込エピにおける溝端部の成長形態とJFET特性

P-94 Embedded epi configuration in the trench edge region and JFET characteristics

竹内有一、杉山尚宏、丸汎ラジエシュクマール (株)デンソー 機能材料研究部

堆積ゲート酸化膜による4H-SiCトレンチMOSキャパシタの電気特性改善

Improvement of Electrical Properties of 4H-SiC Trench MOS Capacitor by Deposited Gate Oxide

P-95 ▲小島貴仁^{1,2}、有吉恵子^{1,3}、米澤喜幸^{1,2}、原田信介^{1,4}、田中保宣^{1,4}、奥村元^{1,4} (¹技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究機構(FUPET)、²富士電機株式会社、³株式会社 東芝、⁴(独)産業技術総合研究所)

二層構造n型ナノ結晶3C-SiC:Hとp型単結晶Siによるヘテロ接合の電気的特性

P-96 Electrical properties of heterojunction of n-type nanocrystalline 3C-SiC:H with two-layer structure and p-type monocrystalline Si

佐藤慎一郎、田畠彰守 (名古屋大学 大学院 工学研究科 電子情報システム専攻)

10-15 kV級4H-SiC PiNダイオードの耐圧特性評価

P-97 Breakdown Characteristics of 10-15 kV-class 4H-SiC PiN Diodes

▲丹羽 弘樹¹、馮 淹¹、須田 淳¹、木本 恒暢¹ (¹京都大学工学研究科)

顕微ラマン分光法およびナノビーム電子線回折法による4H-SiC MOSFETの応力分布評価

P-98 Characterization of Strain Distribution on 4H-SiC MOSFET by Micro Raman Spectroscopy and Nano Beam Electron Diffraction

小坂 賢一¹、迫 秀樹¹、木本 恒暢²、吉川 正信¹ (¹(株)東レリサーチセンター、²京都大学工学研究科電子工学専攻)

NOアニールを行った4H-SiC (11-20) MOSキャパシタ、およびMOSFETの特性評価

Characterization of 4H-SiC (11-20) MOS Capacitors and MOSFETs processed by NO Annealing

P-99 ¹、▲登尾 正人、山本 建策、山本 敏雅、鶴田 和弘、恩田 正一²、副島 成雅、渡辺 行彦³、森本 淳 (¹株式会社デンソー、²株式会社豊田中央研究所、³トヨタ自動車株式会社)

ITO透明ショットキー電極を用いたSiC-SBDのフォトエミッショントマトグラフィー

P-100 Photoemission analysis of SiC-SBD with ITO transparent schottky barrier electrode

坂東 章、鈴木賢二、佐藤貴幸 (昭和電工株式会社 研究開発本部 SiCパワーエレクトロニクスプロジェクト)

宇宙線起因地表中性子によるSiCパワーダイオードのシングルイベントバーンアウト

P-101 Terrestrial Neutron-Induced Single-Event Burnout in SiC Power Diodes

浅井弘彰、杉本憲治、梨山勇、飯出芳弥、芝健輔、松田美恵子、宮崎良雄 (HIREC株式会社)

- P-102 SiC MOS キャパシタで発生するイオン誘起過渡電流波形
Ion Induced Transient Current on SiC MOS Capacitor
牧野 高紘¹、岩本 直也^{1,2}、出来 真斗^{1,3}、小野田 忍¹、大島 武¹、児島 一聰⁴、野崎 真次² (¹日本原子力研究開発機構、²電気通信大学、³徳島大学、⁴産業技術総合研究所)
- P-103 電流減少率による4H-SiC pinダイオードの順方向電圧ドリフト評価
The forward current reduction ratio of 4H-SiC pin diode with the V_F drift
▲逸見哲郎¹、中山浩二¹、浅野勝則¹、宮澤哲哉²、土田秀一² (¹関西電力株式会社、²財団法人電力中央研究所)
- P-104 ラプラスDLTSによる4H-SiC p⁺nダイオードの欠陥評価
Defects Characterization of 4H-SiC p⁺n Diode by Laplace DLTS
小池俊平¹、岩本直也^{1,2}、小野田忍²、大島武²、児島一聰³、小泉淳¹、小野洋¹、内田和男¹、野崎真次¹ (¹電気通信大学 情報理工学研究科、²日本原子力研究開発機構 半導体耐放射線性研究グループ、³産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)
- P-105 ラプラスDLTS測定によるn形6H-SiC 中のnegative-Uセンターの観察
Observation of negative-U centers in n-type 6H-SiC using Laplace DLTS
小泉 淳^{1,2}、V. P. Markevich²、岩本直也^{1,3}、佐々木 将⁴、小池俊平¹、大島 武³、児島一聰⁵、木本恒暢⁴、内田和男¹、野崎真次¹、B. Hamilton²、A. R. Peaker² (¹電気通信大学 大学院情報理工学研究科、²マンチェスター大学、³日本原子力研究開発機構 半導体耐放射線性研究グループ、⁴京都大学 大学院工学研究科、⁵産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター)
- P-106 炭素注入を施した4H-SiC pinダイオードの逆回復特性
Reverse Recovery Characteristics of 4H-SiC pin Diode with Carbon Implantation
田中篤嗣¹、中山浩二¹、浅野勝則¹、宮澤哲哉²、土田秀一² (¹関西電力株式会社、²電力中央研究所)
- P-107 電子線照射した高耐圧4H-SiC pinダイオードの順回復特性
Transient Electrical Characteristics of Electron Irradiated High Blocking Voltage 4H-SiC pin Diode
緒方修二、田中篤嗣、中山浩二、三柳洋一、浅野勝則 (関西電力株式会社 研究開発室 電力技術研究所 プロジェクト研究室)
- P-108 オフ基板上4H-SiCトレンチMOSFETにおける電気特性の異方性の起源
Origin of anisotropic characteristics in 4H-SiC trench MOSFETs on off-cut substrates
新宮 剣太、上岡 義弘、矢野 裕司、畠山 智亮、冬木 隆 (奈良先端科学技術大学院大学)
- P-109 埋め込み構造を有する4H-SiC MOSFETにおけるnチャネルとpチャネルの比較
Comparison between 4H-SiC n- and p-channel MOSFETs with buried channel structure
岡本光央、飯島美和子、長野隆洋、福田憲司、奥村元 (産業技術総合研究所)
- P-110 SiC IGBTの低オン抵抗化
An Investigation of Material limit Characteristics of SiC IGBTs
畠山哲夫、福田憲司、奥村元 ((独)産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクスセンター)
- P-111 690V 1.00mΩcm² SiC ダブルトレンチMOSFET
690V, 1.00mΩcm² 4H-SiC Double-Trench MOSFETs
▲中野佑紀、中村亮太、箕谷周平、坂入寛之、中村孝 (ローム株式会社 研究開発本部 新材料デバイス研究開発センター)
- P-112 4H-SiC Alイオン注入層上に低温熱処理により形成したTi電極の電気特性評価
Electrical characteristics of low-temperature annealed Ti contacts on 4H-SiC layer formed by Al

ion-implantation

中田大輔、小野修一、新井学、山崎王義 (新日本無線株式会社)

All-SiC 3相インバータの伝導性EMI評価

Verification of Conducting Electro-Magnetic Interferences from an All-SiC Three-phase Inverter

P-113

図子 祐輔^{1,2}、佐藤 伸二^{1,3}、松井 康平^{1,4}、谷本 智^{1,2}、村上 善則^{1,2} (¹技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET)、²日産自動車(株)、³サンケン電気(株)、⁴富士電機(株))

30 kW/L 三相400 V All-SiC インバータ

30 kW/L Three-Phase AC 400 V All-SiC Inverter

P-114

佐藤伸二^{1,2}、松井康平^{1,3}、図子祐輔^{1,4}、谷本智^{1,4}、村上善則^{1,4} (¹(技術研究組合)次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構、²サンケン電気、³富士電機、⁴日産自動車)

高速スイッチングSiC JFETを用いた電源回路の開発

Development of Power Supply Circuit by Using SiC JFET with High Speed Switching.

P-115

初川聰¹、築野孝¹、藤川一洋¹、志賀信夫¹、ウリントヤ²、和田和千²、大平孝² (¹住友電気工業株式会社、²豊橋技術科学大学)

単結晶ダイヤモンド基板の超平滑化加工

P-116 Ultra-smoothing process of single crystal diamond substrate

久保田 章亜、峠 瞳 (熊本大学大学院自然科学研究科 産業創造工学専攻)

P-型GaN中の深い準位の評価

P-117 Characterization of deep levels in p-GaN

山田悠二郎¹、長谷川晶一¹、南部大翔¹、本田銀熙¹、徳田豊¹、塩島謙次² (¹愛知工業大学、²福井大学)

高空間分解カソードルミネッセンス分光法によるInGaN量子井戸構造の“V-defect”欠陥の構造解析

P-118 Characterization of V-defect in InGaN InGaN Single-Quantum-Well films by high-spatial-resolution cathodoluminescence spectroscopy

村上昌孝、吉川正信 ((株)東レリサーチセンター)

GaN自立基板上n-GaN面内トラップ濃度分布の評価

Characterization of spatial distribution for trap in n-GaN on GaN freestanding substrates

P-119

山口真太朗¹、丸山雄史¹、松村俊哉¹、本田銀熙¹、徳田豊¹、上田博之²、成田哲生²、上杉勉²、加地徹² (¹愛知工業大学、²豊田中央研究所)

オゾンMBEを用いた高品質 β -Ga2O3エピタキシャル膜の形成

Device-Quality β -Ga2O3 Epitaxial Films Fabricated by Ozone Assisted Molecular Beam Epitaxy

P-120

佐々木 公平¹、倉又 朗人¹、増井 建和²、Encarnaci´n G. Víllora³、島村 清史³、山腰 茂伸¹ (¹株式会社タムラ製作所、²株式会社光波、³物質・材料研究機構)

Si蒸気圧環境に依存したSiC基板上のエピタキシャル・グラフェン成長

Epitaxial graphene growth on SiC under Si-vapor environment

P-121

▲久津間 保徳¹、牛尾 昌史¹、吉井 新¹、玉井 尚登¹、大谷 昇^{1,2}、金子 忠昭^{1,2} (¹関西学院大学 理工学研究科、²関西学院大学 SiC材料・プロセス研究開発センター、)

GaN GIT双方向スイッチの入力容量へのホール注入の影響

P-122 Influence of hole injection for input capacitance in GaN GIT Bi-directional Switch

井手 利英¹、清水 三聰¹、沈 旭強¹、森田 竜夫²、上田 哲三²、田中 納² (¹産業技術総合研究所、²パナソニック)

直接はんだ付けられるAl電極及び高温接合信頼性

High temperature solder joint reliability of the Al electrode with a top wettable metal film

P-123 郎 豊群¹、谷本 智^{3,4}、大橋 弘通²、山口 浩¹、仲川 博¹、佐藤 弘¹ (¹(独)産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター、²(独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門、³技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET)、⁴日産自動車(株) 総合研究所 EVシステム研究所)

SiCエピタキシャル層中の積層欠陥密度に与える基板中転位密度の影響

Influence of the dislocation density in 4H-SiC substrate on the stacking faults density in SiC epitaxial

P-124 layer

百瀬賢治、坂東章、武藤大祐、影島慶明、小田原道哉、宮坂晶、下平祥貴、宮坂佳彦、佐藤貴幸(昭和电工株式会社
SiCパワーエレクトロニクスプロジェクト)

インダストリアルセッション

講演番号	企業（機関）名
IS1-1	(株) ニューメタルスエンドケミカルスコーポレーション
IS1-2	セラミックフォーラム(株)
IS1-3	昭和電工（株）
IS1-4	アイクストロン（株）
IS1-5	東京エレクトロン（株）
IS1-6	モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
IS1-7	フェトン（株）
IS1-8	伯東（株）
IS1-9	(株) ウェーブフロント
IS1-10	(株) シルバコ・ジャパン
IS1-11	クロスライトソフトウェアインク日本支社
講演番号	企業（機関）名
IS2-1	(株) 住化分析センター
IS2-2	(株) 東レリサーチセンター
IS2-3	エバンスナノアナリティカルグループ／ナノサイエンス（株）
IS2-4	名古屋大学
IS2-5	カスケード・マイクロテック（株）
IS2-6	浜松ホトニクス（株）
IS2-7	タカノ（株）
IS2-8	横河フィールドエンジニアリングサービス（株）
IS2-9	(株) リガク
IS2-10	丸文（株）
IS2-11	(株) ニデック
IS2-12	レーザーテック（株）

【7階展示場】
10:45～12:00

【7階展示場】
13:30～15:10